

2006年年会「リエゾン・セッション」研究発表募集

行事企画委員会

【セッション導入のねらい】

2006年年会(2006年3月14日(火)～16日(木)東京大学駒場キャンパス)より新たに「リエゾン・セッション」を導入いたします。リエゾンは、参加者相互の研究交流の橋渡しになればという希望を込めたことばであり、年会在より深い研究交流の場に発展することを目的としています。

日本セラミックス協会の年会は、会員の皆様による活発な研究発表を軸とし、多種多様なセラミックスに関する情報交換の場として定着しております。異なる研究機関で行われているセラミックスの研究には、相互の連携によってはじめて実を結び、このことがセラミックス技術の進展および業界全体の発展につながると期待されるものが多数含まれています。そこで、このたびすべての会員がセラミックスに関するすべての分野で自由に発表できるという年会の特徴を活かしたセッションを企画しました。産官学の間、異なる産業技術分野の間、メーカーとユーザーの間等での積極的な連携を希望されている会員の皆様にご活用頂きたいと考えております。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

【研究発表の内容】

参加者相互の研究交流推進という目的から、従来、一般発表されていた研究のうち、例えば以下のような内容に関するものは、本セッションでの発表をお願いいたします。連携を目的として既発表の内容に新規な内容を加えた総合講演でも結構です。ただし、何らかの形で既に連携が行われているなどの理由で、新たに他機関が加わることでできない研究は本セッションの対象にはなりません。

セラミックス材料の実用化に向けて官学界が育成しており、これに産業界が加わることによって実際の製品化が期待される研究

産業界が抱えている、新製品や現製品に係る技術的課題の解決の糸口となるような研究

既存技術の高度化や応用展開に関する研究

セラミックスのエンドユーザーにとって将来のビジネスの種となる研究

産業界からのニーズの提示や共同研究の提案

その他、産官学連携が日本のセラミックスの発展に寄与すると期待される研究であれば、「リエゾン・セッション」のご活用をお願い申し上げます。

【申込方法】

Webによる2006年年会発表申込の際、「リエゾン・セッションでの発表を希望する」の項目を設定いたしますので、ラジオボタンにて選択してください。セッション・コードも適切なものを選んでください。申込まれた研究発表について審査は行わず、プログラム編成の際、全て「リエゾン・セッション」に組み込ませていただきます。

【発表形式】

「リエゾン・セッション」は(口頭発表)に限定いたします。本セッションへの申込の際は、ご希望の発表形式を(口頭発表)としてください。発表時間は、一般口頭発表と同じく15分(発表10分、質疑応答4分、交代1分)といたします。発表時間が不足する場合は、連続講演としてください。

【プログラム・予稿集での取扱い】

プログラムに「リエゾン・セッション」であることを明記いたします。予稿集にリエゾン・セッション一覧を掲載いたします。

web 経由の申込受付期間

受付開始(予定) 11月8日(火) 14:00, 締切 11月24日(木) 14:00

申込 web URL

http://www.ceramic.or.jp/ig-nenkai/index_j.html

「リエゾン・セッション」に関するお問合せは電子メールにて nenkai-ml@cersj.org までお願いいたします。